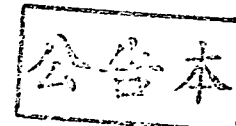


發明專利說明書



(本說明書格式、順序及粗體字，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※ 申請案號： 95134147

※ 申請日期： 95.9.15

※IPC 分類：B65D5/10 (2006.01)

一、發明名稱：(中文/英文)

覆蓋膠帶及製造方法

COVER TAPE AND METHOD FOR MANUFACTURE

二、申請人：(共 1 人)

姓名或名稱：(中文/英文)

美商3M新設資產公司

3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY

代表人：(中文/英文)(簽章)

羅伯特 W 史普拉格

SPRAGUE, ROBERT W.

住居所或營業所地址：(中文/英文)

美國明尼蘇答州聖保羅市3M中心

3M CENTER, SAINT PAUL, MINNESOTA 55133-3427, U.S.A.

國 籍：(中文/英文)

美國 U.S.A.

三、發明人：(共 3 人)

姓 名：(中文/英文)

1. 盧賓 E 維拉斯奎姿 俄瑞
VELASQUEZ UREY, RUBEN E.
2. 蘿拉 克拉克 迪凡尼
DEVANEY, LAURA CLARK
3. 大衛 J 凡諾佛貝克
VANOVERBEKE, DAVID J.

國 籍：(中文/英文)

1. 美國 U.S.A.
2. 美國 U.S.A.
3. 美國 U.S.A.

四、聲明事項：

☐ 主張專利法第二十二條第二項 ☐ 第一款或 ☐ 第二款規定之事實，其事實發生日期為： 年 月 日。

☒ 申請前已向下列國家（地區）申請專利：

【格式請依：受理國家（地區）、申請日、申請案號 順序註記】

☒ 有主張專利法第二十七條第一項國際優先權：

1. 美國；2005年09月16日；11/228,956

2. 美國；2006年08月09日；11/463,569

☐ 無主張專利法第二十七條第一項國際優先權：

1.

2.

☐ 主張專利法第二十九條第一項國內優先權：

【格式請依：申請日、申請案號 順序註記】

☐ 主張專利法第三十條生物材料：

☐ 須寄存生物材料者：

國內生物材料 【格式請依：寄存機構、日期、號碼 順序註記】

國外生物材料 【格式請依：寄存國家、機構、日期、號碼 順序註記】

☐ 不須寄存生物材料者：

所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存。

五、中文發明摘要：

本發明揭示一種包括一種覆蓋膠帶之物件，該覆蓋膠帶包括一基膜層、可撕扯部位及一黏著劑。該基膜層具有對置縱向邊緣及頂部和底部表面。該等可撕扯部位大致平行於該等縱向邊緣且位於該等頂及底表面處。

六、英文發明摘要：

七、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：第 (1) 圖。

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

20	覆蓋膠帶
22	膜
24	縱向邊緣
26	縱向邊緣
28	頂部面
30	底部面
31	可撕扯部位
32	可撕扯部位
33	可撕扯部位
34	可撕扯部位
40	中心區域
42	頂部塗層
44	底部塗層
46	黏著劑條
48	黏著劑條

八、本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式：

(無)

九、發明說明：

【發明所屬之技術領域】

本發明係關於用於承載組件之膠帶。

【先前技術】

於製造裝配中，經常需要固持並運輸組件。舉例而言，在電子電路組配之領域中，經常自一組件供應源將電子組件運載至一電路板上之特定位置以附裝至該電路板。該等組件可係數種不同的類型，其中包括表面安裝組件。特定實例包括記憶體晶片、積體電路晶片、電阻器、連接器、處理器、電容器、開陣列等。可使用一承載膠帶/覆蓋膠帶系統(例如，第5,325,654號美國專利中所揭示者)來運輸小型精密組件。

電子工業正不斷向更小器件及(因而)更小組件方向發展，此本身需要更精密且準確地自該承載膠帶/覆蓋膠帶系統移除該等組件。大多數已知的覆蓋膠帶使用熱熔性黏著劑(HAA)或感壓黏著劑(PSA)以將該覆蓋膠帶黏接至該承載膠帶。移除該等組件係藉由以下步驟來完成：首先自該承載膠帶小心地剝離或使該覆蓋膠帶脫離黏接以將該組件暴露於吸氣嘴或其他用於安全移動組件之組件搬運設備。

然而，已知之覆蓋膠帶存在數種操作困難。舉例而言，自該承載膠帶剝離該覆蓋膠帶會造成「震動」、粗糙、不均勻且不連貫之剝離，此導致該承載膠帶/覆蓋膠帶移動從而可能會使該等小型組件移位。亦已知震動之剝離會將

該等小型組件拋出該承載膠帶內之袋囊，因而導致拾取失敗並最終關閉自動組件搬運設備。

依據該覆蓋膠帶之寬度及所使用承載膠帶之類型，該黏著覆蓋膠帶之剝離力可變化很大。較寬之HAA覆蓋膠帶需要較高的熱來獲得牢固的接合。類似地，較寬PSA覆蓋膠帶具有較低剝離力且需要較寬之黏著暴露面以獲得牢固黏合。另外，為一種類型承載膠帶(例如，聚苯乙烯)而設計之覆蓋膠帶對於其他類型之承載材料(例如，聚碳酸酯)並不總是具有良好效能。即使覆蓋膠帶的確在名義上能與不同類型之承載膠帶一起使用，但其可能具有不理想之剝離力及非均勻之剝離。此外，HAA覆蓋膠帶亦具有不良穩定性，此乃因剝離力會隨著時間及溫度而降格所致。

【發明內容】

本發明之各態樣能提供一種能與各種承載膠帶一同良好使用之覆蓋膠帶，此乃由於本發明中剝離力並非係自該承載膠帶移除該覆蓋膠帶時的主要因素所致。

於本發明之一態樣中，一物件包括一覆蓋膠帶，該覆蓋膠帶包括：一基膜層，其具有對置之縱向邊緣及上和下表面；一毗鄰於該等縱向邊緣之黏著劑；及位於該基膜層上及下表面處之可撕扯部位，該等可撕扯部位大致平行於該等縱向邊緣且位於該黏著劑之內部。

於本發明另一態樣中，一製造一覆蓋膠帶之方法包括：提供一具有對置縱向邊緣及上和下表面之基膜層；形成位於該基膜層上及下表面處之大致平行於該等縱向邊緣之可

撕扯部位；及毗鄰於該等縱向邊緣且於該等可撕扯部位之外部施加一黏著劑。

上述摘要並非旨在闡釋本發明之每一所揭示之實施例或每一實施方案。下文圖式及詳細說明將更具體地舉例闡述說明性實施例。

【實施方式】

本發明之態樣係關於一種覆蓋膠帶、一種承載膠帶/覆蓋膠帶系統，並且關於一種製造一覆蓋膠帶之方法。根據本發明之覆蓋膠帶可黏著至一能固持組件以便儲存及傳輸之承載膠帶。該覆蓋膠帶可覆蓋該運載膠帶內之能固持組件的袋囊，且具有一可自該系統分離以暴露該承載膠帶內之袋囊之部分。該覆蓋膠帶上之可撕扯部位可允許用一大體上連貫一致且均勻之分離力自該覆蓋膠帶之其他部分(及該覆蓋膠帶所黏著之承載膠帶)分離該覆蓋膠帶之該部分，此可降低該承載膠帶所固持之組件在該分離過程期間非合意移動之可能性。如本文中所使用，術語「撕扯」通常意指有控制地分離一膠帶之若干部分。另外，根據本發明之覆蓋膠帶實施例可具有沿該覆蓋膠帶縱向邊緣之視情況選用之凹陷，該等凹陷幫助該覆蓋膠帶在儲存及應用期間維持一相對平坦之輪廓。該黏著劑之位置通常係與該覆蓋膠帶之邊緣間隔開，此幫助防止該黏著劑之污染且防止該黏著劑非合意地黏著至其他表面(例如，覆蓋膠帶之搬運設備)。

圖1係一適合在一承載膠帶/覆蓋膠帶系統中使用之覆蓋

膠帶20之剖面示意圖。覆蓋膠帶20包括一細長膜22，細長膜22分別具有對置之縱向邊緣24和26及對置之頂部和底部面28及30。膜22可係一聚合物膜，例如，聚對苯二甲酸乙二酯、定向聚丙烯(例如，二軸定向聚丙烯)、定向聚醯胺、定向聚氯乙稀、聚苯乙烯、聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯腈、聚烯烴及聚醯亞胺膜。膜22可係透明。另外，膜22可具有固有的導電性或防靜電性。

縱向延伸之可撕扯部位31和33及32和34係相對於膜22之頂部面28及底部面30定位。可撕扯部位組31/32及33/34彼此間隔，且膜22之一中心部分40界定於該兩者之間。可撕扯部位32及34可位於沿底部面30之任何位置處，且可撕扯部位31及33可位於沿頂部面28之任何位置處，只要其皆自膜22之縱向邊緣24及26間隔開。上部可撕扯部位31及33可位於下部可撕扯部位32及34之內部(如圖1中所示)，或可位於下部可撕扯部位之外部。該等上部及下部可撕扯部位在膜22之內部可如圖1中所示不重疊(亦即，超過對方繼續延伸)，或其可如圖3中所示重疊。該等上部及下部可撕扯部位可或可不具有相同之長度。舉例而言，一者可較另一者短，如圖1中所示，下部可撕扯部位32及34比上部可撕扯部位31及33長。如圖1中所示，可撕扯部位31、32、33及34係沿膜22縱向延伸之連續劃線。可藉由切割至膜22內(例如，使用雷射、沖刀、及刀片)來形成該等劃線。另一選擇係，可撕扯部位31、32、33及34可係膜22之薄弱區域(例如，不同材料之介面、較薄的區域、穿孔部分等)。

視需要，沿膜22之頂部面28設置一頂部塗層42。頂部塗層42可包括一防靜電(SD)塗層、LAB(亦即，一黏著劑釋放塗層)、一防反射或減眩光塗層及其他塗層以及塗層之組合。視需要，亦可沿膜22之底部面30設置一底部塗層44，其可係一SD塗層或其他類型之塗層且至少可部分地與膜22混合。底部面30之外邊緣上設置有縱向設置之黏著劑條46及48。黏著劑條46及48可(例如)係壓敏黏著劑(PSA)、熱熔性或微囊封黏著劑。

圖2中所示之實施例具有視情況選用之凹陷36及38。凹陷36及38分別位於膜22之縱向邊緣24及26處。凹陷36及38各自分別膜22之面向底部面30及邊緣24和26敞開。一底部部分50及一側面部分52界定凹陷36及38之每一者。黏著劑條46及48可分別設置於凹陷36及38之底部部分50上。凹陷36及38之底部部分50可具有顯微組織(圖1中未顯示)以便更好地將黏著劑條46及48黏著至膜22。應認識到，可利用其他凹陷形狀，只要凹陷36及38係面向膜22之毗鄰細長邊緣24或26及膜22之底部面30敞開。可使用(例如)如下製程來形成具有凹陷36和38之膜22：劃線、擠壓、壓延、微複製、雷射燒蝕、超音波、沖切、化學蝕刻及剝離。

可撕扯部位31和33及32和34係分別相對於膜22之頂部面28及底部面30定位，且可毗鄰凹陷36及38定位於其側面部分52處。

於一實施例中，以實例而並非限定之方式來提供，覆蓋膠帶20可具有下述尺寸。膜22之總寬度 W_0 (量測於細長邊

緣 24 及 26 之間)大約係 1 英吋 (2.54 cm)。膜 22 之厚度 T 大約係 2 mil (0.0254 mm) (以膜 22 之中心區域 40 最厚的部分來量測)。凹陷 36 及 38 各自具有一約 0.0393701 英吋 (1 mm) 之寬度 W_R 及一約 0.5 mil (0.0127 mm) 之厚度 D_R 。可撕扯部位 32 及 34 係各自具有一約 1.5 密耳 (0.0381 mm) 深度 D_T (自膜 22 之底部面 30 量測) 之劃線。可撕扯部位 31 及 33 分別直接位於可撕扯部位 32 及 34 上方，且具有小於 1.5 mil 之深度。應瞭解，覆蓋膠帶 20 之尺寸可按要求變化。舉例而言，可對膜 22 之中心部分 40 之寬度進行選擇以使其至少與一承載膠帶 (其與覆蓋膠帶 20 一同使用) 之袋囊一樣寬。

圖 3 係一覆蓋膠帶 20 之另一實施例之剖面示意圖。上部可撕扯部位 31 及 33 位於下部可撕扯部位 32 及 34 之內部。該等上部及下部可撕扯部位在膜 22 之內部中重疊，亦即，超過對方繼續延伸。上部可撕扯部位 31、33 比可撕扯部位 32、34 長。

圖 4 係一覆蓋膠帶 100 之另一實施例之剖面示意圖。覆蓋膠帶 100 通常類似於覆蓋膠帶 20，然而，膜 22 包括一第一材料 104 及一第二材料 106。對於覆蓋膠帶 100，第二材料 106 自細長邊緣 24 或 26 延伸至材料介面 108。膜 22 之中心部分 40 界定於材料介面 108 之間。材料介面 108 展示出較第一材料 104 或第二材料 106 之內部接合或黏結強度為弱之接合或連接強度。材料介面 108 之相對薄弱便於大致連貫且均勻地撕扯，亦即，於材料介面 108 處分離第一材料 104 與第二材料 106。因此，材料介面 108 可形成可撕扯部位。材料

介面108所形成之單一可撕扯部位類似於本發明其他實施例中之一組上部及下部可撕扯部位，例如，31及32。於兩種情形下，膜22之上部及下部表面皆存在可撕扯部位。

通常，第一及第二材料104及106可選自上文關於圖1至2所論述之相同類型之材料。於某些實施例中，第一材料104可較第二材料106為弱，或反之亦然。換而言之，一種材料可具有較另一種材料為弱之內部黏結或接合特性。此外，膜22之中央部分40可係透明且具有高光學透明度，而該膠帶之外部部分無需如此。

可使用諸如共擠壓及型面擠出等製程來製造覆蓋膠帶100之膜22。藉由共擠壓將第一及第二材料104及106按照一合意之佈置擠壓至一起。藉由型面擠出，按照合意形狀單獨地擠壓第一及第二材料104及106並在初始單獨擠壓製程之後仍在熔化時使其結合。製造可導致第一與第二材料104及106於其介面處(例如，圖4中之介面108處)發生某些可忽略之混合。於該實施例種，該等可撕扯部位不需要劃線。

圖5係一覆蓋膠帶102之另一實施例之剖面示意圖。覆蓋膠帶102通常類似於覆蓋膠帶100且具有可視情況選用之凹陷36及38。膜22包括第一材料104及第二材料106。對於覆蓋膠帶102，第二材料106設置於位於凹陷36及38之側面部分52附近之細長帶條110及112內，其中第一材料104設置於第二材料106之帶條110及112之任一側上。膜22之中心部分40被界定於第二材料106之帶條110與112之間。

第二材料106通常較第一材料104為弱。換而言之，第二材料106具有較第一材料104為弱之內部黏結或接合特性。此便於連貫並均勻地撕扯第二材料106之帶條110及112內之膜22。因此，帶條110及112構成可撕扯部位。帶條110或112所形成之單一可撕扯部位類似於本發明其他實施例中之一組上部及下部可撕扯部位，例如，31及32或33及34。於兩種情形下，膜22之上部及下部表面皆存在可撕扯部位。於某些實施例中，第一材料104可抗撕扯。第二材料106可包含一不同於且較第一材料104為弱形式之材料類型，或可係一完全不同類型之材料。第一及第二材料可通常選自上文關於圖1至2所論述之相同類型之材料。另外，較弱之第二材料106可由乙烯醋酸乙烯酯(EVA)製成。於該實施例中，該等可撕扯部位並不需要劃線。

可在覆蓋膠帶製造之後及在黏著至一承載膠帶之前將其捲成一捲。將該覆蓋膠帶捲成一個捲可方便該覆蓋膠帶之儲存及運輸以及自動搬運。覆蓋膠帶頂部面上之塗層材料可方便自該捲撕去該覆蓋膠帶之部分。

覆蓋膠帶可用於一承載膠帶/覆蓋膠帶系統內。圖6係一包括一承載膠帶132及覆蓋膠帶20之承載膠帶/覆蓋膠帶系統130之透視圖。承載膠帶132具有一對對置之細長凸緣部分134及一個或多個袋囊136。可將組件138(例如，電子組件)置放於袋囊136內。組件138置放於承載膠帶132之袋囊136內後，視需要，可將覆蓋膠帶20黏著至細長凸緣部分134以覆蓋袋囊136並將組件138容納於承載膠帶132與覆蓋

膠帶20之間。可自一捲分配覆蓋膠帶20。

為暴露並移除組件138，自系統130分離覆蓋膠帶20之一部分。如圖6中所示，撕去覆蓋膠帶20之界定於可撕扯部位32與34(圖中未顯示可撕扯部位31及33)之間之中心部分40。在撕去覆蓋膠帶20之中心部分40之後，覆蓋膠帶20之外部部分140仍黏著於承載膠帶132。在撕去後，覆蓋膠帶120之中心部分40可捲成一捲142以便丟棄或再循環。

覆蓋膠帶20之中心部分40係於可撕扯部位31/32及33/34(例如，關於圖1至2所顯示並闡述之實施例中之劃線)處分離。於其他實施例中，依據可撕扯部位之類型及位置，分離可發生於材料介面處(例如，如關於圖4所顯示並闡述之材料介面108)、較為薄弱之材料帶條處(例如，關於圖5所顯示並闡述之第二材料106之帶條110及112)、或其他位置處。

圖7係一承載膠帶/覆蓋膠帶系統130之另一實施例之透視圖，該承載膠帶/覆蓋膠帶系統包括一承載膠帶132及覆蓋膠帶21。覆蓋膠帶21通常類似於覆蓋膠帶20，然而除了可撕扯部位31/32及33/34之外，膜22還包括位於外部部分140內之定向撕扯部位35以便當首先自承載膠帶132移除該覆蓋膠帶時可起始沿每一個可撕扯部位組31/32及33/34之撕扯。定向撕扯部位35可係(例如)位於覆蓋膠帶21之外部部分140內之彼此間隔開之裂口、狹縫、劃線或穿孔部分。於另一實施例中，可藉由沿外部部分140之週邊邊緣提供一系列楔形物或三角形切口(未顯示)來形成定向撕扯

部位35。若提供楔形物，則該楔形物之邊緣可小於或等於90°。定向撕扯部位35亦可用於本發明之諸如彼等顯示於圖4及5中之覆蓋膠帶實施例。

定向撕扯部位35之間的間距可具有隨機或間歇性或可如圖7中所示為等距。定向撕扯部位35自外部部分140之週邊邊緣向裏朝中心部分40延伸且通常相對於外部部分140之週邊邊緣沿覆蓋膠帶21之移除方向傾斜小於90°。定向撕扯部位無需為圖7中所示之直線。其可部分地或整體地為彎曲，例如，其可係弓形形狀，其中「弓形」係指一定向撕扯部位之彎曲形狀，於該彎曲形狀中該可撕扯部位之引導端(亦即，該定向撕扯部位之毗鄰於該覆蓋膠帶邊緣定位之邊緣)係沿一不同於其拖曳端(亦即，該撕扯起始部位之毗鄰於該可撕扯部位定位之邊緣)之方向定向以致該定向撕扯部位之一部分具有尖銳的曲形而另一部分具有一平坦的曲形。「尖銳」係指具有狹窄縮緊尖頂之曲形而「平坦」係指具有寬闊伸長尖頂之曲形。可使用交替的定向撕扯部位形狀。儘管定向撕扯部位35可散佈在整個外部部分140上，但定向撕扯部位35之間的適合間距大約係4 mm(0.157英吋)至約254 mm(10英吋)。

當自承載膠帶132開始剝離覆蓋膠帶21時，外部部分140可能會與中心部分40一同自承載膠帶132被拉開。隨著繼續拉動覆蓋膠帶21，覆蓋膠帶21內之撕扯力或張力會於定向撕扯部位35處重定向至使外部部分140自中心部分40分離之可撕扯部位31/32、33/34，因此外部部分140不會再自

承載膠帶 132 分離。為確保撕扯力的重新定向，每一定向撕扯部位 35 之長度較佳地自外部部分 140 之週邊邊緣延伸至可撕扯部位 31/32、33/34。然而，為防止中心部分 40 被意外地撕開，定向撕扯部位 35 較佳地不延伸至中心部分 40 內。舉例而言，若覆蓋膠帶 132 之寬度係 5.4 mm(0.213 英吋)且每一外部部分 140 之寬度 0.665 mm(0.02618 英吋)，則每一定向撕扯部位 35 之長度係 0.66 mm(0.02598 英吋)且成 45 度之角度。當然，外部部分 140 及定向撕扯部位 35 之寬度可隨著覆蓋膠帶 132 之寬度增加而增加。

當撕去該覆蓋膠帶之一部分時，使用一大致均勻之撕扯力係合意者。儘管可使用雷射或刀片來形成劃線，但藉由雷射來製造變化能夠小於 0.001 英吋(0.0254 mm)之多個精確劃線將係昂貴，且藉由習知用途之刀片幾乎係不可能，刀片刀口對準之變化會防礙該等刀片之使用。

為達成均勻地撕扯具有劃線之覆蓋膠帶，則期望提供沿該覆蓋膠帶長度且於不同劃線之間幾乎沒有深度變化之劃線。可使用同在申請中之第 11/228956 號專利申請案中所述之方法及裝置簡單有效地將具有大致均勻深度之劃線形成於一膜網中，該專利申請案以引用方式併入本文。

鑒於上文之論述，應認識到本發明之諸多優點及益處。根據本發明之覆蓋膠帶之一優點係：其具有移除該膠帶中心部分之非常均勻的力，此減少在儲存及運輸作業期間由於零件或組件「跳」出該承載膠帶之承載袋囊而導致拾取失敗之風險。

儘管上文已參照數個替代實施例對本發明進行了闡述，但熟習此項技術者應理解，在不背離本發明之精神及範圍前提下可在形式及細節上做出若干改變。舉例而言，可根據本發明使用各種類型的可撕扯部位，且彼等可撕扯部位可具有各種佈置。

【圖式簡單說明】

圖1係一根據本發明之覆蓋膠帶之剖面示意圖。

圖2係一根據本發明之覆蓋膠帶之另一實施例之剖面示意圖。

圖3係一根據本發明之覆蓋膠帶之再一實施例之剖面示意圖。

圖4係一根據本發明之覆蓋膠帶之又一實施例之剖面示意圖。

圖5係一根據本發明之覆蓋膠帶之又一實施例之剖面示意圖。

圖6係一根據本發明之承載膠帶/覆蓋膠帶系統之透視圖，其顯示自該承載膠帶/覆蓋膠帶系統分離該覆蓋膠帶。

圖7係一根據本發明之承載膠帶/覆蓋膠帶系統之透視圖，其顯示自該承載膠帶/覆蓋膠帶系統分離該覆蓋膠帶。

儘管上述附圖闡述了本發明之數個實施例，但如論述中所提及本發明亦涵蓋其他實施例。於所有情形中，本揭示內容係以代表但非限定之方式提出本發明。應理解，熟習

此項技術者可構想出諸多其他修改形式及實施例，該等修改形式及實施例屬於本發明原理之精神及範圍內。該等圖式可能不按比例繪製。於所有圖式中，使用相同參考編號來表示相同之部位。

【主要元件符號說明】

20	覆蓋膠帶
21	覆蓋膠帶
22	膜
24	縱向邊緣
26	縱向邊緣
28	頂部面
30	底部面
31	可撕扯部位
32	可撕扯部位
33	可撕扯部位
34	可撕扯部位
35	定向撕扯部位
36	凹陷
38	凹陷
40	中心區域
42	頂部塗層
44	底部塗層
46	黏著劑條
48	黏著劑條

50	底部部分
52	側面部分
100	覆蓋膠帶
102	覆蓋膠帶
104	第一材料
106	第二材料
108	材料介面
110	帶條
112	細長帶條
130	承載膠帶 / 覆蓋膠帶系統
132	承載膠帶
134	凸緣部分
136	袋囊
138	組件
140	外部部分

十、申請專利範圍：

1. 一種物件，其包括：

覆蓋膠帶，其包括：

基膜層，其具有對置縱向邊緣及上和下表面；

毗鄰於該等縱向邊緣之黏著劑；及

位於該基膜層之該等上部及下部表面處而大致平行於該等縱向邊緣且位於該黏著劑內部之可撕扯部位，

其中該基膜層包含置於沿該基膜層之寬度方向之外部部分之間的中心部份，該中心部份及外部部分大致平行於該等縱向邊緣，該中心部份包含第一材料且該外部部分包含第二材料，該等可撕扯部位包含一介於該中心部份及該外部部分之間之介面。

2. 如請求項1之物件，其進一步包括沿該等縱向邊緣延伸之凹陷區域，其中該黏著劑位於該等凹陷區域上。
3. 如請求項1之物件，其中該黏著劑係選自由如下組成之群組：壓敏、熱熔性及微囊封黏著劑。
4. 如請求項2之物件，其中該黏著劑具有之寬度等於或小於該等凹陷區域之寬度。
5. 如請求項2之物件，其中每一凹陷內之該黏著劑皆自該基膜層之該縱向邊緣間隔開。
6. 如請求項2之物件，其中每一凹陷內之該黏著劑皆自一毗鄰之可撕扯部位間隔開。
7. 如請求項1之物件，其中每一可撕扯部位皆沿該縱向方向延伸。

101年10月5日

8. 如請求項1之物件，其中每一可撕扯部位包括一位於該基膜層內之較弱區域。

9. 如請求項1之物件，其中該等可撕扯部位提供一大體上連貫一致之撕扯力。

10. 如請求項1之物件，其中該覆蓋膠帶進一步包括撕扯起始部位，該等撕扯起始部位自該縱向邊緣相對於一可撕扯部位以一小於或等於90°之角度朝至少一個可撕扯部位延伸。

11. 如請求項1之物件，其進一步包括：

一承載膠帶，其內形成有用於固持組件之隔室，其中將該覆蓋膠帶黏著至該承載膠帶以密封該等隔室內之組件。

12. 一種製造一覆蓋膠帶之方法，該方法包括：

提供一具有對置縱向邊緣及上和下表面之基膜層，該基膜層包含置於沿該基膜層之寬度方向之外部部分之間的中心部份，該中心部份及外部部分大致平行於該等縱向邊緣，該中心部份包含第一材料且該外部部分包含第二材料，一介於該中心部份及該外部部分之間之介面，其形成大致平行於該等縱向邊緣之可撕扯部位；及

施加一毗鄰於該等縱向邊緣且位於該等可撕扯部位外部之黏著劑。

13. 如請求項12之方法，其進一步包括形成沿該等縱向邊緣延伸之凹陷區域並將該黏著劑施加於該等凹陷區域上。

14. 如請求項13之方法，其中形成該等凹陷區域之該步驟包

101年10月5日修(更)正後發

括一選自如下組成之群組之製程：劃線、擠壓、壓延、
微複製、雷射燒蝕、超音波、化學蝕刻及剝離。

十一、圖式：

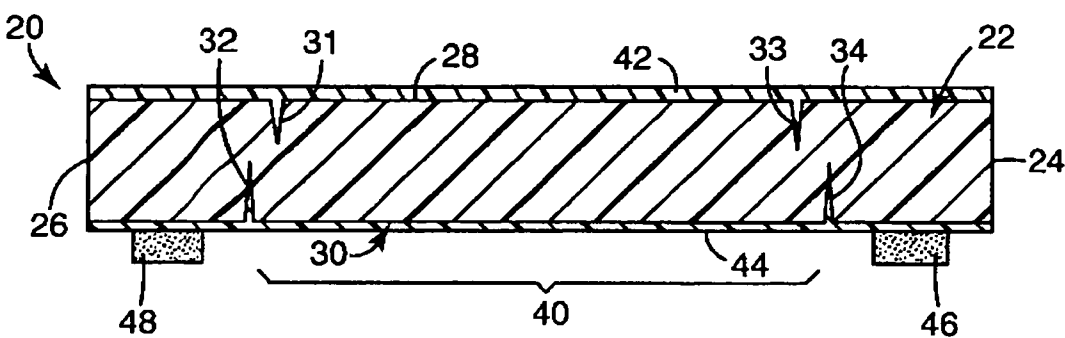


圖 1

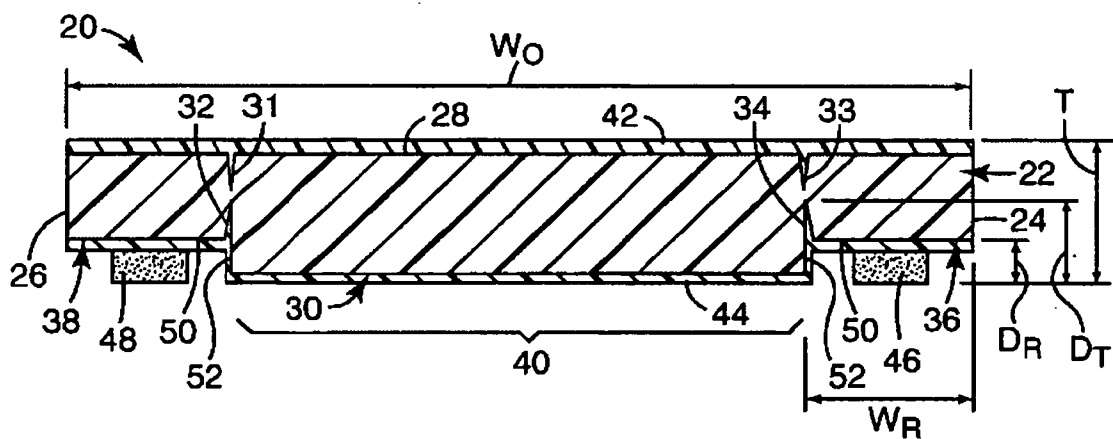


圖 2

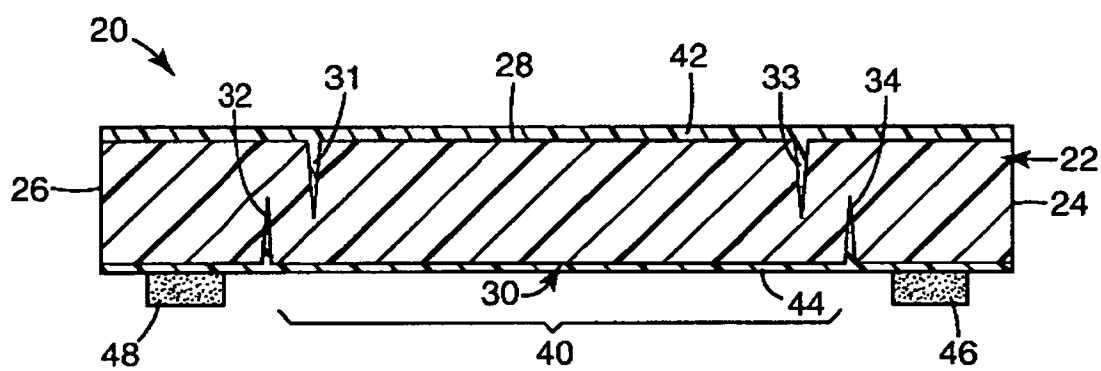


圖 3

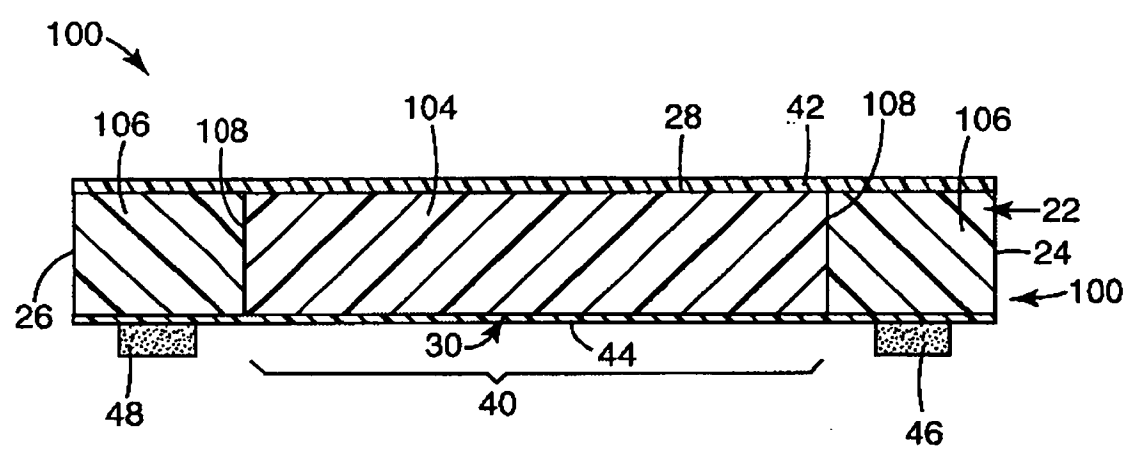


圖 4

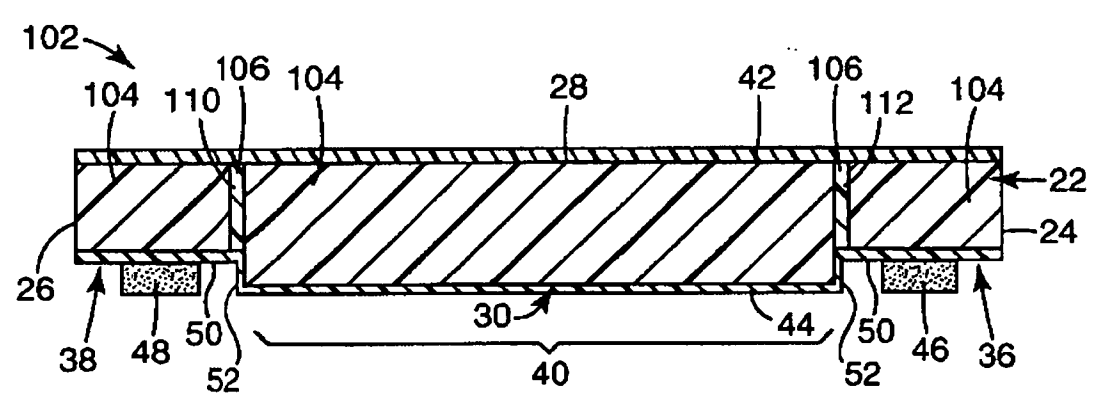


圖 5

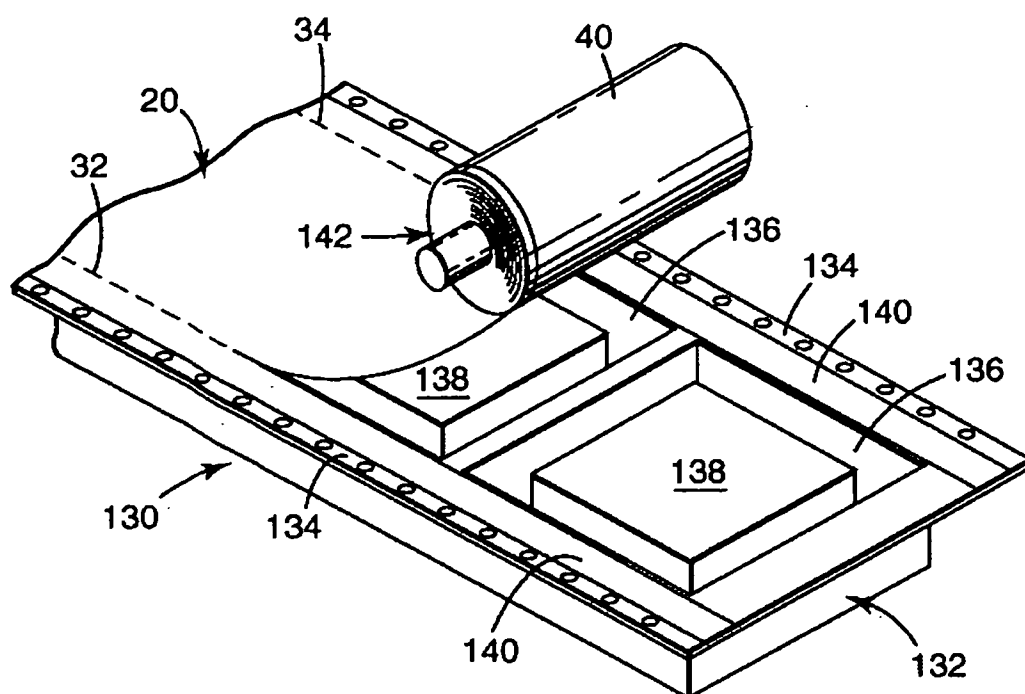


圖 6

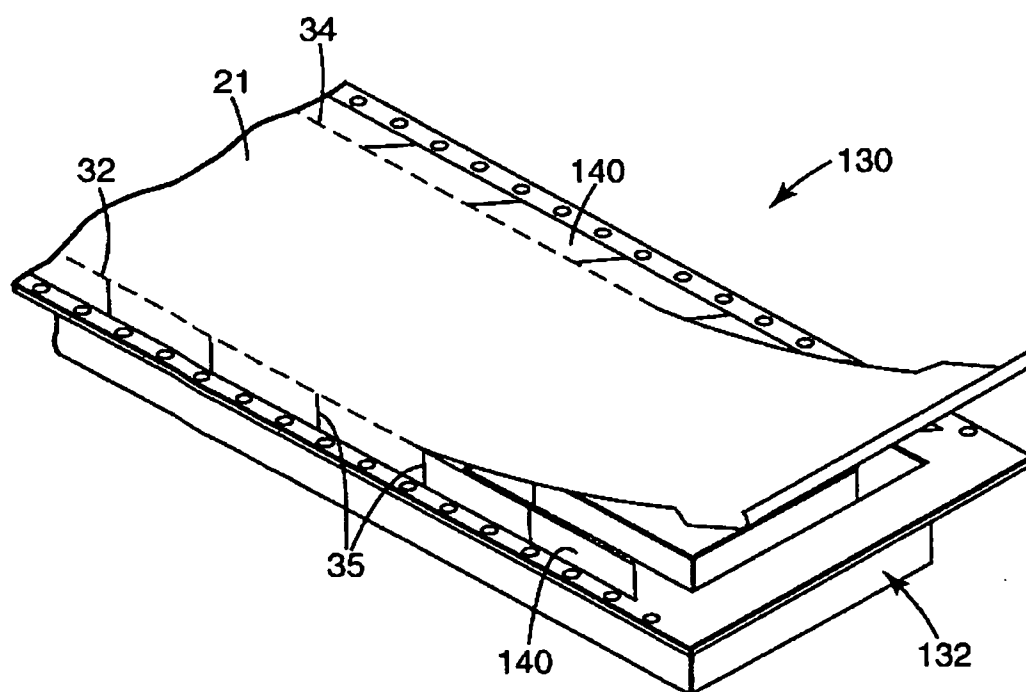


圖 7